

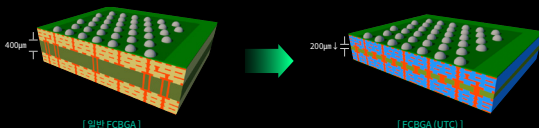
FCBGA (UTC)

개요

OVERVIEW

SET 슬림화를 위한 박형 패키지 기판

- 응용분야 : 노트북용 CPU, Tablet PC용 CPU 등



핵심 기술

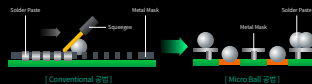
CORE TECHNOLOGY

Laser PTH 개발



- 기술 번복점: CNC+INK → Laser+Cu Fill
- Void Free PTH: 전기적, 열적 특성 향상

미세 Bump Pitch



- Conventional 공법 : Min.150µm
- Micro Ball 공법 : Min.100µm

주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

기판 층수	8~12층
Core 두께	100µm ~ 200µm
회로 (Line/Space)	9/12µm
미세 Via Size & Bump Pitch	49µm & 100µm

※ UTC : Ultra Thin Core